

Vendredi 29 septembre 2017

10h00 à 12h00

Salle Loire - Site STMicroelectronics

10 rue Thalès de Milet
37100 Tours

Pour vous inscrire, merci de
remplir **ce formulaire**.

SILIMIXT



life.augmented

vermon

world leader in Composite Packaging, Transducers



Séminaire scientifique

Procédés de packaging et d'interconnexions
des composants électroniques

**Taiko et futures évolutions process pour
l'amincissement des wafers**

Thomas GUILLEMET - STMicroelectronics

**Nouveaux procédés de wirebonding (titre à
confirmer)**

Marie PERROTEAU - Vermon

**Etude de l'inter-diffusion Cu-Sn en
microélectronique de puissance**

Yousra BETTAHI - STMicroelectronics

CERTeM • 26 rue Pierre et Marie Curie • 37100 Tours

Tel. : 02 47 42 41 72 • Mail : certem@univ-tours.fr

Web : certem.univ-tours.fr •  CERTeM